



平成22年8月11日

各位

上場会社名 TOWA株式会社  
 代表者 代表取締役社長 西村 永和  
 (コード番号 6315)  
 問合せ先責任者 執行役員 管理本部長 岸本 昌利  
 (TEL 075-692-0251)

## 業績予想の修正に関するお知らせ

最近の業績動向を踏まえ、平成22年5月13日に公表した業績予想を下記の通り修正いたしましたのでお知らせいたします。

記

### ● 業績予想の修正について

平成23年3月期通期連結業績予想数値の修正(平成22年4月1日～平成23年3月31日)

	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益	1株当たり当期純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円	円 銭
前回発表予想(A)	20,000	1,000	900	800	31.98
今回発表予想(B)	22,000	2,900	2,850	2,800	111.94
増減額(B-A)	2,000	1,900	1,950	2,000	
増減率(%)	10.0	190.0	216.7	250.0	
(ご参考)前期実績 (平成22年3月期)	14,274	△338	△345	△330	△13.19

平成23年3月期通期個別業績予想数値の修正(平成22年4月1日～平成23年3月31日)

	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益	1株当たり当期純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円	円 銭
前回発表予想(A)	19,000	700	600	500	19.99
今回発表予想(B)	21,300	2,600	2,550	2,500	99.95
増減額(B-A)	2,300	1,900	1,950	2,000	
増減率(%)	12.1	271.4	325.0	400.0	
(ご参考)前期実績 (平成22年3月期)	13,481	△572	△451	△371	△14.87

修正の理由

平成23年3月期第1四半期の連結売上高は当初の想定を上回る水準で推移し、足もとの受注動向も引き続き堅調であることから、平成22年7月29日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」のとおり、第2四半期累計期間の業績予想を修正いたしました。半導体市場は、新興国向けの電子機器需要の増加等に強く牽引され、引き続き安定した成長を持続するものと思われませんが、下期においては半導体の需要に一時的な調整局面が想定されることから、各半導体メーカーの設備投資は上期に比してやや減速する可能性があります。したがって、当社は下期の連結売上高予想は当初計画通りの100億円とし、通期の連結売上高予想を220億円といたしました。一方、損益につきましては、連結売上高が当初計画を上回ることや、継続して取り組んでまいりました製品の原価低減、効率的な生産体制の確立等により当初計画を大きく上回る水準を確保しております。為替相場の変動など不安定要素はあるものの、現在の市場環境においては大幅な利益率の変動を強いられる事態は想定されず、通期業績予想の営業利益は19億円引き上げ29億円、経常利益は19億500万円引き上げ28億500万円、当期純利益は20億円引き上げ28億円を見込んでおります。

### ● 配当予想の修正について

	1株当たり配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
前回予想 (平成22年5月13日発表)	—	0.00	—	—	—
今回修正予想	—	0.00	—	10.00	10.00
当期実績	—	—	—		
前期(平成22年3月期)実績	—	0.00	—	0.00	0.00

修正の理由

平成22年5月13日発表の決算短信においては、半導体市場の継続的な回復を見極める必要があるため平成23年3月期の期末配当を未定としておりましたが、平成23年3月期第1四半期の業績が想定を上回る水準となったことに加え、今期の半導体市場は一時的な調整局面はあるものの、おおむね順調に推移するものと考えられることから、上記のとおり期末配当を行うことといたしました。

以上